

CMPチーム

<氏名> 中村 由夫

<役職> チームリーダー

<所属> 不二越機械工業株式会社

<開発内容>

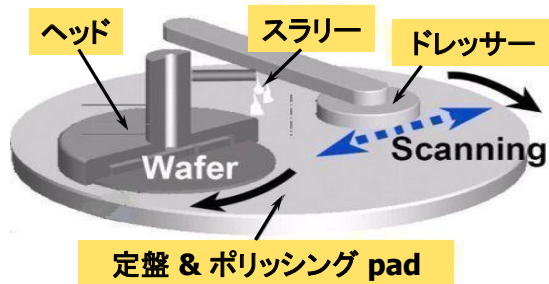
ミニマルCMP装置とは、シャトルに入ったミニマルウェーハをCMP加工し、洗浄、乾燥後再びシャトルに戻す装置です。研磨部分の小型化、極小化はもちろん、小型洗浄、小型乾燥機構を開発。電力、研磨材、洗浄液の微少流量コントロール開発を進め。装置内に薬液の供給から回収まで出来る装置を実現します。また 超小型膜厚計を開発し、研磨の終点も自動で検出し全自動ポリッシング装置化を図ります。

CMP (Chemical Mechanical Polishing) : 化学機械研磨

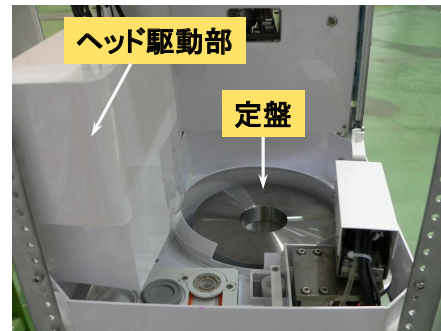
<自己紹介>

1982年 芝浦工業大学 機械工学第二学科卒業後、現不二越機械工業(株)に入社 以後 遊離砥粒を使った加工機マルチブレードソウ, Lapping装置の設計, ポリッシング装置の設計に従事。2007年3月より次世代機開発を主とする開発研究部に異動 現在に至る。第三種電気主任技術者

ミニマルCMP装置開発



CMP装置の基本構成



開発機の構成



加工中の様子